
LASER X
LASER X
ALL POWER
POWER ON
POWER OFF
PC POWER
RJ45 USB3.0

全自动耦合机

产品特性

主流机型	单Lens耦合，双Lens耦合，单FA耦合，双FA耦合
可以满足以下封装类型和不同封装工艺类型	COB，陶瓷基板，SIOB，PLC芯片，硅光芯片，COC To PIC SIOB，COC To FA，COC To Collimator，V-groove，BOX
可以满足以下类型产品的耦合生产需求	CWDM，DR系列，FR系列，光引擎，LR4，ER4，SOA（半导体光放大器）,可调激光器、相干类产品、激光传感器，RGB激光产品
可以满足以下元器件的耦合需求	ZR，XPO，NPO，CPO，Tunable，PON，DMUX，准直器，适配器，SIOB，COC，PIC，SOA，Etalon
设备特点	搭配了高精度图像辅助定位系统 ，有效提高了生产效率和产品品质
	搭配了高精度纳米级别的运动滑台(位置重复精度±50nm)，可以满足不同类型产品生产需求，最大限度地减少客户在产品更新换代时重复设备投资的浪费
	模块化设计，可以根据客户需求快速组合出最佳方案的设备
	同步耦合系统，有效提高了复杂光路多器件耦合生产效率和产品品质
	自动校准系统，有效降低了对调试工程师和生产工人的要求
	客户可以自由实现不同类型产品和不同耦合工艺的生产，能有效减少新产品研发周期和投资
	分级权限管理软件，能有效控制管理生产设定参数和工艺及保密需求
	为客户提供多款自动化上下料耦合方案，可实现弹匣上下料流水线对接，提升整体产能，减少人员依赖，提升设备利用率